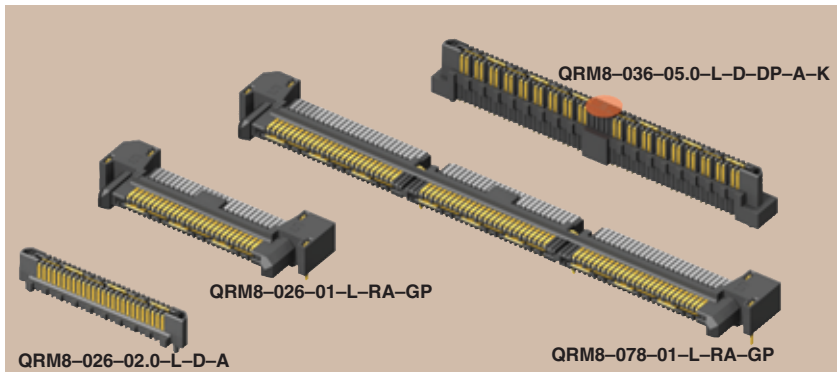




(0,80mm) .0315"

QRM8, QRM8-RA 系列



微塑体接地板

QRM8 板配接:

QRF8

QRM8-RA 板配接:

QRF8 (需要 -GP)

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览

www.samtec.com?QRM8 或 www.samtec.com?QRM8-RA

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

端子与接地板材料:



磷青铜

电镀:

50μ" (1,27μm) 的

镍底上镀金或镀锡

额定电流:

QRM8 = 环境温度 80°C 时 2.0A

QRM8-RA = 1.5A @ 95°C

(6 个触点通电)

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

QRM8 = 215 VAC

QRM8-RA = 230 VAC/325 VDC

符合 RoHS 规范要求:

是可无铅焊接:

是

QRM8	每排引脚数对数	引线式样	电镀选项	类型	A	其他选项												
	-026, -052, -078 (每排共 52 个引脚 = -D) -018, -036, -054 (每排 18 对 = -D-DP)	-02.0 = 2mm 主体高度 (不适用于 -054 与 -078 位置) -05.0 = 5mm 主体高度 -07.0 = 7mm 主体高度	-L = 10μ" (0,25μm) 触点镀金, 焊尾镀雾锡	-D = 单端 -D-DP = 差分对	<table border="1"> <thead> <tr> <th>引线式样</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-02.0</td> <td>(4,81) .189</td> <td>(6,12) .241</td> </tr> <tr> <td>-05.0</td> <td>(7,81) .307</td> <td>(9,12) .359</td> </tr> <tr> <td>-07.0</td> <td>(9,78) .385</td> <td>(11,12) .438</td> </tr> </tbody> </table>	引线式样	A	B	-02.0	(4,81) .189	(6,12) .241	-05.0	(7,81) .307	(9,12) .359	-07.0	(9,78) .385	(11,12) .438	-GP = 导柱 (配接连接器需要 -GP) -K = (5,00mm) .197" 直径聚酰亚胺薄膜取放垫 -TR = 卷带封装
引线式样	A	B																
-02.0	(4,81) .189	(6,12) .241																
-05.0	(7,81) .307	(9,12) .359																
-07.0	(9,78) .385	(11,12) .438																

配接高度*	
QRM8 引线式样	QRF8 引线式样
	-05.0 -07.0
-02.0	(7,00) .276 (9,00) .354
-05.0	(10,00) .394 (12,00) .472
-07.0	(12,00) .472 (14,00) .551

*加工条件将影响配接高度。

7mm 堆叠高度	类型	在 3dB 插入损耗的额定值
单端信号传输	-D	9.5 GHz / 19 Gbps
差分对信号传输	-DP	8.5 GHz / 17 Gbps

如需了解其他堆叠厚度的性能数据和完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?QRM8 或联系 sig@samtec.com

QRM8	每排位置数	01	电镀选项	RA	GP	选项
	-026, -052, -078 (每排共 52 个位置)		-L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡			-K = (7,00mm) .275" 直径聚酰亚胺薄膜取放垫 (仅 -052) -TR = 卷带封装 (仅 -026 与 -052)

每排位置数	A	B
-026	(33,46) 1.317	(20,00) .787
-052	(58,26) 2.294	(44,80) 1.764
-078	(83,06) 3.27	(69,60) 2.74

注: 用于 -GP (导柱选项) 至 -GP (导柱选项) 配接。

注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。